



■ 四半期連結貸借対照表

科目	期別 当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	前第2四半期連結会計期間 (平成24年9月30日)
<b>資産の部</b>			
流動資産	12,830	14,867	15,011
固定資産	10,416	5,959	5,551
有形固定資産	5,667	4,350	4,243
無形固定資産	3,153	56	51
投資その他の資産	1,596	1,552	1,256
<b>資産合計</b>	<b>23,247</b>	<b>20,826</b>	<b>20,562</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債	2,141	594	627
固定負債	1,112	655	641
<b>負債合計</b>	<b>3,253</b>	<b>1,249</b>	<b>1,269</b>
<b>純資産の部</b>			
株主資本	19,660	19,731	19,803
その他の包括利益累計額	315	△169	△519
新株予約権等	17	14	10
<b>純資産合計</b>	<b>19,993</b>	<b>19,576</b>	<b>19,293</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>23,247</b>	<b>20,826</b>	<b>20,562</b>

■ 四半期連結損益計算書

科目	期別 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
売上高	4,467	2,416
売上総利益	1,273	878
販売費及び一般管理費	1,181	896
営業利益	91	△18
経常利益	104	5
税金等調整前四半期純利益	105	0
四半期純利益	△25	△54

■ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目	期別 当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	242	△123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△588	△178
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,914	1,163

決算のポイント

不二電子工業株式会社の株式取得に伴い、貸借対照表と損益計算書が前期から大きく変動しています。

□ 貸借対照表

不二電子工業株式会社の株式取得により、流動資産は前期末から2,037百万円減少しました。一方、建物や機械装置、のれん等の固定資産は前期末から4,457百万円増加しました。この結果、総資産は前期末から2,420百万円増加しました。また、買掛金や退職給付引当金等が増えたことで、負債合計は前期末から2,003百万円増加しました。純資産は為替換算調整勘定の増加等により、前期末から416百万円増加しました。

□ 損益計算書

売上高は、金型関連やレンズ関連が厳しかったものの、光製品関連が前年同期比で20%の増収となったほか、不二電子工業株式会社を連結子会社に加えたこと等により、前年同期から2,050百万円増加しました(前年同期比85%増)。損益面は、光製品関連と不二電子工業株式会社が牽引したことにより、91百万円の営業利益となり、前年同期から109百万円の利益改善となりました。

□ キャッシュ・フロー

第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,914百万円となり、前期末から284百万円減少しました。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益や買掛金の増加、減価償却費、定期預金の預入れと払戻しの差額等があります。資金減少の主な要因は、不二電子工業株式会社の株式取得による支出等です。

■ 株式の状況

発行済株式総数	9,333,654株
株主数	3,483名

■ 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	毎年3月31日
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031

取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

株式会社精工技研 広報課

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296番地の1

TEL 047-388-6401(直通) FAX 047-388-4477

E-mail ir@seikoh-giken.co.jp WEB http://www.seikoh-giken.co.jp

株主通信

第42期 第2四半期(累計)事業報告

平成25年4月1日～平成25年9月30日

ごあいさつ

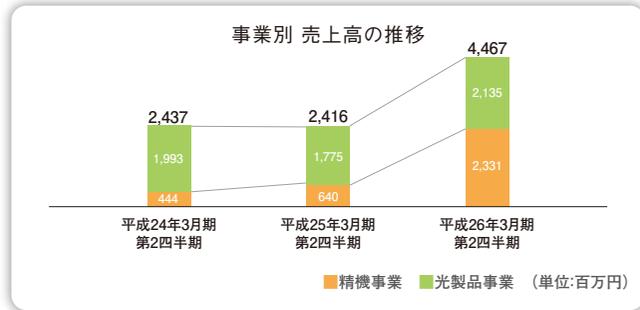
平素より当社に対しまして格別のご支援を賜り、誠にありがとうございます。当第2四半期連結累計期間は、精機関連と光製品関連の両セグメントの事業拡大に努めました。不二電子工業株式会社を連結子会社に加え、既存顧客の維持と新規顧客の開拓にも取り組んだ結果、営業利益を回復させることができました。今後とも、安定的に成長することのできる力強い企業体質を確立すべく邁進してまいりますので、株主の皆様におかれましては、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

上野 昌利



## 事業別の概況



### 精機事業 超精密金型 / 精密加工 / レンズ

業界最高水準の金型技術と精密加工技術で、お客様の製品開発と生産性向上を支援します。



微細な溝を施した成形品



スマートフォン用レンズ

光ディスク成形用金型関連の販売は、光ディスク成形メーカー各社の新規設備投資が停滞しているほか、高耐熱レンズも顧客の仕様見直しにより、受注が減少いたしました。一方、本年5月にグループに加わった不二電子工業株式会社の自動車用センサーやスマートフォン向けの電子部品等は好調に売上を伸ばしました。これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,331百万円となりました。

### 光製品事業 接続部品 / 光部品 / 製造機器

光通信ネットワークの高速・大容量化を支える高精度な技術・製品を提供します。



MPOコネクタ



MT研磨機

光回線を通る情報データの増加に伴い、光通信用品の所要量は世界的な規模で拡大しており、これらの製造過程で用いられる検査装置等の需要も増加基調にあります。この旺盛な需要を受注につなげることができ、中国の製造子会社ではフル生産体制が続きました。また、材料調達コストの削減や生産性の向上、製品設計や仕様の見直しによる原価低減に取り組まれました。これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,135百万円となりました。

## 継続的な企業価値向上を実現するために

### 「小型」「精密」「光学」をキーワードに、お客様が求めるニーズにお応えしてまいります。

当社は現在、2010年度から2015年度までの長期経営計画『マスタープラン2010』を遂行中です。当期は、「黒字体質の確立」に向けて、『マスタープラン2010』で定めた事業拡大戦略に基づく様々な施策を講じております。上半期に実施した不二電子工業株式会社の子会社化により、連結売上高100億円を視野に捉えることができました。

長期的には、既存事業のさらなる拡大と新規事業の創出を並行して実施していくことで、安定的に企業価値を向上できる体質を築いてまいります。

### 長期的な成長イメージ



#### 新規事業創出

前期から当期にかけて、新たなパートナーとの提携を積極的に進めました。昨年8月にはフランスの光通信用部品の測定器メーカーであるDATA-PIXEL SAS社、本年1月には台湾のコンタクトレンズメーカーである精能光学股份有限公司に出資。5月には静岡市の不二電子工業株式会社を連結子会社化したことなどにより、「医療」や「自動車」といった当社グループにとって新しい事業領域への一歩を踏み出しています。



#### 既存事業拡大 (新製品開発)

精機事業においては、内製した金型をベースに精密な樹脂成形品を開発。ガラスや金属製の部品素材を樹脂に置き換えることで、お客様の原価低減に貢献します。また、レンズ関連では、耐熱性の高い高画素レンズの量産ラインを中国杭州の製造子会社に新設。中国やアジア市場に向けたスマートフォンや携帯電話に搭載するカメラレンズの受注獲得を目指します。



#### 既存事業拡大 (既存製品)

販売拡大に向けては、国内・国外で開催された展示会に積極的に出展。多くの新しいお客様候補との貴重な出会いの場となりました。また、不二電子工業株式会社との間では、金型の内製化や製造原価の低減等、両社のシナジーを具体的な形にするための取り組みが始まっています。

